

PowerEdge R670



透過最佳化電源和平衡效能，提升資料中心效率。

提升資料中心效率和效能

Dell PowerEdge R670 是一款 1U、雙插槽機架式伺服器，專為高效能運算而設計，具備最佳電源效率和平衡效能，可提升資料中心生產力。它能平衡進階運算能力，且支援虛擬化、雲端原生應用程式、全快閃記憶體 SDS (軟體定義儲存)、超大規模工作負載和橫向擴充資料庫。

PowerEdge R670 專為企業級和可擴充基礎結構打造，提供易於整合至現有環境的標準化功能。搭載兩個具備 E 核心和 P 核心的 Intel® Xeon® 6 處理器，每瓦效能較前代機型提升高達 1.69 倍，改善電源效率並提高機架密度。加入 GPU 支援進一步提升運算能力，確保在降低能源使用的同時維持高效能。

這些伺服器提供後方 I/O 熱通道和前方 I/O 冷通道組態。前方 I/O 冷通道可改善檢修性，縮短維護時間，提升效率、可靠性和運作時間，透過最佳化冷卻和能源使用來支援您的永續發展目標。它還具備 Dell 的智慧電源與冷卻技術，針對氣體冷卻進行最佳化，可大幅降低能源消耗，有助於節省長期營運成本。

適用於零信任 IT 環境與作業的網路韌性架構

安全性已整合至 PowerEdge 生命週期的每個階段，包括受保護的供應鏈和原廠到府完整性保證。晶片式信任根可錨定端對端開機復原能力，而多因素驗證 (MFA) 和角色型存取控制則可保障受信任的作業。

透過自主協作提升效率並加速作業

Dell OpenManage Systems Management 產品組合能克服管理和保護 IT 基礎結構的複雜難題。IT 可以使用 Dell Technologies 直覺式端對端工具，減少程序和資訊孤島，藉此提供安全且經過整合的體驗，進而專注拓展業務。Dell OpenManage 產品組合是創新引擎的關鍵，可充分發揮工具和自動化功能，協助您擴充、管理並保護技術環境。

永續發展

從產品和包裝中的回收材料，到精心設計的創新節能選項，PowerEdge 產品組合在製造、交付及回收產品方面的設計，有助於減少碳足跡並降低您的營運成本。有了 Dell Technologies，您甚至可以透過負責任的方式，輕鬆淘汰老式系統。

Dell Technologies Services 讓您更安心

無論您身在何處，全方位服務旨在滿足您的需求，讓您充分發揮 PowerEdge 伺服器效能。使用 AI 專屬的專業服務讓高階 AI 使用案例加速創造價值，借助 ProDeploy Suite 選擇量身打造的部署選項，透過 ProSupport Suite 獲得主動式預測支援，還有我們的更多其他服務，在 170 個地點提供，由超過 6 萬名員工和合作夥伴提供支援。

PowerEdge R670

Dell PowerEdge R670 採用 Intel Xeon 6 處理器、DDR5 記憶體、NVMe BOSS、符合能源之星規範，並具備進階冷卻技術。適用於：

- 虛擬化
- 雲端原生應用程式
- 全快閃記憶體 SDS
- 超大規模工作負載
- 橫向擴充資料庫

注意：本文件提供完整的產品功能清單。但是，標有星號 (*) 的功能在產品推出時可能尚無法使用，會在未來的更新中加入。請注意，本文件並未確認任何功能的可用性或發佈時間表。如需功能可用性最準確且最新的相關資訊，請參閱 [dell.com](https://www.dell.com) 上的產品組態工具頁面。

功能	技術規格	
處理器	兩個 Intel Xeon 6 處理器 (每個處理器最多 144 個 E 核心或 86 個 P 核心)	
記憶體	32 個 DDR5 DIMM 插槽，最高支援 RDIMM 8 TB，速度最高可達 6400 MT/秒 - 僅支援暫存 ECC DDR5 DIMM	
儲存控制器	- 內部開機：開機最佳化儲存子系統 (BOSS-N1 DC-MHS)：HWRaid 1，2 個 M.2 NVMe SSD 或 M.2 中介板 (DC-MHS)：2 個 M.2 NVMe SSD 或 USB - 內部控制器：前側 PERC H965i、前側 PERC H975i、前側 PERC H365i	
前側托架	- 無底板組態 - 最多 8 個 EDSFF E3.S NVMe，最大 122.88 TB，也具備 FIO 組態 - 最多 16 個 EDSFF E3.S Gen5 NVMe，最大 245.76 TB - 最多 20 個 EDSFF E3.S Gen5 NVMe，最大 307.2 TB - 最多 8 個 2.5 in SAS/SATA/NVMe Direct/NVMe Raid，最大 122.88 TB 8 個 2.5 in 通用 245.6 TB - 最多 10 個 2.5 in SAS/SATA，最大 38.4 TB - 後側最多 2 個 EDSFF E3.S Gen5 NVMe，最大 30.72 TB	
熱交換電源供應器	1500 W 鈦金級 100-240 VAC 或 240 VDC 1100 W 鈦金級 100-240 VAC 或 240 VDC 800 W 鈦金級 100-240 VAC 或 240 VDC 1100 W 白金級 100—240 VAC 或 240 VDC 800 W 白金級 100—240 VAC 或 240 VDC 1,800 W HLAC 鈦金級 200—240 VAC 或 240 VDC* 1,500 W 277 VAC 或 336 VDC* 1,400 W LVDC -48 — -60 VDC*	
散熱選項	- 氣體冷卻和直接液體冷卻 - 注意：DLC 是機架解決方案，需要機架多孔裝置和冷卻分配裝置 (CDU) 才能運作。	
風扇	- 高效能銀級 (HPR SLVR) 或標準 (STD) 風扇 - 最多 4 組 (雙風扇模組) 熱交換風扇	
尺寸與重量	高：42.8 公釐 (1.69 吋) 寬：482 公釐 (18.98 吋) 重量：20.42 公斤 (45.02 磅)	深度 (適用於背面 I/O 組態) 816.92 mm (32.20 吋) 含外框 815.14 mm (32.09 吋) 不含外框 深度 (適用於前置 I/O 組態) 829.44 mm (32.66 吋) 不含外框 注意：前置 I/O 組態不支援邊框。
外型規格	1U 機架式伺服器	
嵌入式管理	- iDRAC - iDRAC Direct - iDRAC RESTful API with Redfish - RACADM CLI - iDRAC Service Module (iSM) - Quick Sync 2 無線模組 - NativeEdge 端點 - NativeEdge Orchestrator	
前蓋	選配的防盜前蓋	
安全保護	- 透過密碼編譯的簽署韌體 - 資料重設加密 (使用本機或外部金鑰管理的 SED) - Secure Boot (安全開機) - 安全的元件驗證 (硬體完整性檢查) - Secure Erase - Silicon Root of Trust - 系統鎖定 - TPM 2.0 FIPS、CC-TCG 認證 - 機箱入侵偵測	
網路選項	4 張 OCP NIC 3.0 卡 (選配) 和 1 GbE、10 GbE、25 GbE、100 GbE 和 400 GbE* 插槽 31：前側擴充板 1 個 16 OCP 3.0 插槽 32：前側擴充板 1 個 16 OCP 3.0 插槽 2：1 個 16 OCP 3.0 插槽 5：1 個 8 Gen5 OCP 3.0 或 1 個 16 Gen5 OCP 3.0	
BOSS	插槽 34：1 個 4 BOSS 插槽 3：1 個 4 BOSS	
GPU 選項	最多3 個 75 W SW	
連接埠	正面連接埠： 1 個 USB 2.0 Type-C 連接埠 1 個 USB 2.0 Type-A 連接埠 (選配) 1 個 Mini-DisplayPort (選用) 1 個 DB9 序列 (含前 I/O 組態) 1 個用於 iDRAC 管理的專用乙太網路連接埠	背面連接埠： 1 個用於 iDRAC 管理的專用乙太網路連接埠 1 個 VGA 2 個 USB 3.1 Type-A 連接埠
	內部連接埠： 1 個 USB 3.1 Type A 連接埠	

功能	技術規格
PCIe	• 最多 2 個 16 Gen5 PCIe 插槽 • 插槽 31：前側擴充板 1 個 16 全高-半長或全高-全長或 1 個 16 OCP 3.0 • 插槽 32：前側擴充板 1 個 16 全高-半長或全高-全長或 1 個 16 OCP 3.0 • 最多 3 個 16 或 2 個 8 Gen5 PCIe 插槽 • 插槽 1：1 個 16 全高-半長或全高-全長或 3 個 16 或 1 個 8 短版-半長 • 插槽 2：1 個 16 或 1 個 8 短版-半長或 1 個 16 OCP 3.0 • 插槽 4：1 個 16 全高-半長或 1 個 16 短版-半長
作業系統和 Hypervisor	• Canonical Ubuntu Server LTS • Microsoft Windows Server 具備 Hyper-V (僅限 P 核心) • Red Hat Enterprise Linux • SUSE Linux Enterprise Server • VMware ESXi 如需規格和互用性詳細資料，請參閱 Dell.com/OSsupport
提供 OEM 版本	從邊框、BIOS 到包裝，您可以讓伺服器的外觀與風格就像由您親手設計及打造一般。如需更多資訊，請造訪 Dell.com -> 「解決方案」-> 「OEM 解決方案」。

*預計將在未來版本中提供。規劃的產品可能會有變更，且推出後可能會與原始設計不同。

注意：從邊框、BIOS 到包裝，我們的 OEMR 平台可讓您的伺服器呈現彷彿由您親自設計和打造的外觀與質感，而 XL 平台則為 OEM Solutions 客戶提供延長的轉換期和穩定性。如需更多資訊，請造訪 Dell.com -> 「解決方案」-> 「OEM 解決方案」。

APEX Flex on Demand

取得您需要的技術來支援不斷變化的業務，付款方式可依實際使用情況調整。如需更多資訊，請造訪 <https://www.delltechnologies.com/en-us/payment-solutions/flexible-consumption/flex-on-demand.htm>。

深入探索 PowerEdge 伺服器



深入瞭解
PowerEdge 伺服器的
服務



深入瞭解我們的系統
管理解決方案



搜尋我們的
資源庫



追蹤 X (先前的
Twitter) 上
PowerEdge 伺服器



聯絡 Dell Technologies
專家以獲得銷售協助或
技術支援